# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

1/1 JAPIO - (C) JPO

PN - JP 07044502 A 19950214 [\*\*\*JP07044502\*\*\*]

TI - DUALMICROPROCESSOR

IN - ANEZAKI MITSUGI

PA - NEC CORP

AP - JP18838293 19930729 [1993JP-0188382]

IC1 - G06F-015/16

IC2 - G06F-015/16

- AB PURPOSE: To obtain a microprocessor with a small mounting area suitable for load distribution processing by adhering two microprocessors formed in a face symmetry back to back.
  - CONSTITUTION: Microprocessors 1, 2 formed in a face symmetry are adhered back to back. External memory access control circuits 12, 22 implement read control of a program conducted by CPUs 10, 20 from an external memory and write control to cache memories 11, 12. The contention produced by using one external bus 300 by two external memory access control circuits 12, 22 is avoided by providing priority to one as a master processor and giving a bus use right to an external memory access circuit belonging to the processor. Common sharing memories 16, 26 are accessed by both of the CPUs 12, 20 and the access contention produced by allowing both the CPUs 10, 20 to make simultaneous access is avoided by executing an access request from the master processor with priority.
  - COPYRIGHT: (C)1995,JPO

### (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-44502

(43)公開日 平成7年(1995)2月14日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

G06F 15/16

S 7429-5L

350 R 7429-5L

審査請求 有 請求項の数5 OL (全6頁)

(21)出願番号

特願平5-188382

(22)出顧日

平成5年(1993)7月29日

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 姉崎 貢

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

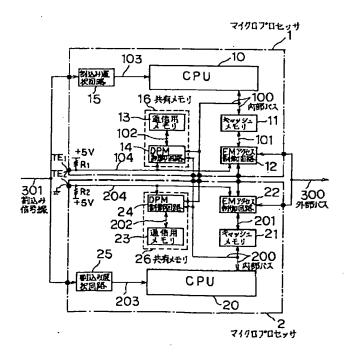
(74)代理人 弁理士 若林 忠

#### (54) 【発明の名称】 デュアル マイクロプロセッサ装置

#### (57)【要約】

【目的】 マイクロプロセッサにおいて、面対称に作成 した2つのプロセッサを裏面同士貼り合わせることによ り処理能力を向上させるとともに実装面積を削減するこ とを目的とする。

【構成】 2つの面対称のマイクロプロセッサは、独立 動作を可能とするため、それぞれキャッシュメモリ、外 部アクセス制御回路、共有メモリ、割込み選択回路を備 え、裏面同士貼り合わされている。外部バスの使用競 合、共有メモリのアクセス競合を避けるために、優先権 設定回路が設けられている。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1のマイクロプロセッサが形成されている第1のチップと、

第1のマイクロプロセッサと同一の構成要素で成り、各構成要素が第1のマイクロプロセッサの対応する構成要素と相互に面対称の位置に配置されている第2のマイクロプロセッサが形成されている第2のチップとを有し、第1,第2のチップは、裏面が相互に貼り合わされてIC基板に固定され、

第1,第2のマイクロプロセッサはそれぞれ、第1,第2のCPUと、それぞれのCPUが実行すべきプログラムが格納される第1,第2のキャッシュ メモリ手段と、それぞれのキャッシュ メモリ手段に読み込むべきプログラムが格納されている外部メモリを外部バスを介してアクセス制御し、かつ、第1,第2のキャッシュメモリ手段をそれぞれアクセス制御する機能を有する第1,第2の外部メモリアクセス制御手段と、第1および第2のCPUのアクセス要求に従ってアクセスされる第1,第2の共有メモリ手段を有し、

第1,第2のマイクロプロセッサは、さらに前記外部バスを優先使用するための外部バス使用権と、第1および第2の共有メモリ手段へのアクセスを優先実行するための共有メモリアクセス権との両者を、第1,第2のマイクロプロセッサのいずれか一方に設定する優先権設定手段を有する、デュアル マイクロプロセッサ装置。

【請求項2】 第1のキャッシュ メモリ手段は、第1のCPUが実行すべきプログラムを第1のキャッシュメモリ手段が蓄積していないとき、または第1のCPUがプログラムを実行するために必要なデータを第1のキャッシュ メモリ手段が蓄積していないとき、外部メモリへのアクセス要求を出力する手段を備え、

第1の外部メモリアクセス制御手段は、優先権設定手段が第1のマイクロプロセッサに外部バス使用権を設定している場合において、第1のキャッシュ メモリからアクセス要求があったときには、第2の外部メモリアクセス制御手段の外部バス使用を禁止し、外部バスを経由して外部メモリから前記プログラムまたは前記データを読み出して第1のキャッシュ メモリ手段に書き込み、第1のキャッシュ メモリからのアクセス要求がないとストリアクセス制御手段の外部バス使用を許可し、優先権設定手段が第2のマイクロプロセッサに外部バス使用権を設定している場合において、第1のキャッシュ メモリ手段からアクセス要求があったときには、第2の外部メモリアクセス制御手段の許可を得て、外部メモリへアクセスする手段を備え、

第1および第2の共有メモリは、第1,第2のCPUから同時にアクセス要求があったときには、優先権設定手段が共有メモリアクセス権を設定しているマイクロプロセッサに属するCPUからのアクセス要求に優先的に応答する手段を備えている、請求項1に記載の装置。

【請求項3】 デュアル マイクロプロセッサ装置は負荷分散処理用の装置であり、各CPUが実行すべきプログラムは、負荷分散処理のために当該CPUに割当てられたジョブを実行するためのプログラムである、請求項2に記載の装置。

【請求項4】 第1,第2のCPUは、それぞれが実行した分散処理結果に関する情報である第1,第2の情報をそれぞれ第1,第2の共有メモリ手段に書き込み、第1のCPUから第2のCPUへの通信は、第2のCPUが第1の共有メモリ手段から第1の情報を読み出すことによって行われ、第2のCPUから第1のCPUへの通信は、第1のCPUが第2の共有メモリ手段から第2の情報を読み出すことによって行われる、請求項3に記載の装置。

【請求項5】 第1,第2のマイクロプロセッサはそれぞれ第1,第2の割込み選択回路を有し、第1,第2の割込み選択回路は、同一のボンディング端子を介して外部装置から割込み信号を入力して第1,第2のCPUのそれぞれに割当てられているジョブに該当する割込み要求を第1,第2のCPUに伝達する、請求項4に記載の装置。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、デュアル マイクロプロセッサ装置に関し、特に、分散処理用デュアル マイクロプロセッサ装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】最近、マイクロプロセッサを用いた処理 装置は、益々、高い処理能力をもつことが要求されてい る。この要求は、場合によっては単一のマイクロプロセ ッサの処理能力の限度を超えるまでになる。この問題を 解決するために、複数のCPUを用いるマルチプロセッ サ方式が数多く提案されている。このような方式の一例 として、特開昭61-50223号に記載されたデュア ル プロセッサ システムを挙げることができる。この システムは、2つのプロセッサを備え、それぞれのプロ セッサにはメモリが設けられている。これらのメモリ は、バスで相互に接続され同じデータが保持されてい る。このデュアル プロセッサ システムは、所定の条 件に応答して第1のモードと第2のモードのいずれかを 選択して動作する。第1のモードでは両方のプロセッサ が活性状態にあって、独立してそれぞれのタスクを実行 する。第2のモードでは、一方のプロセッサが不活性で 他方のプロセッサは活性であり、活性のプロセッサは、 前記それぞれのタスクのうちの選択されたタスクを実行 する。このようにして処理能力および信頼性を向上させ るようにしている。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】上記の従来のデュアルマイクロプロセッサ システムにおいては、基板上に

2つ分のマイクロプロセッサ及び周辺回路部品を乗せる 必要があり2倍の面積を必要とし、また、マイクロプロ セッサの機能が複雑になるほど端子の数が多くなり専有 面積が大きくなるとともに、配線のために多層基板を使 用しなければならないという問題点があった。本発明の 目的は、各々のマイクロプロセッサが独立に動作するこ とが可能で実装面積が小さく、負荷分散処理に適したデ ュアル マイクロプロセッサ装置を提供することにあ る。

#### [0004]

【課題を解決するための手段】本発明のデュアル マイクロプロセッサ装置は、第1のマイクロプロセッサが形成されている第1のチップと、第1のマイクロプロセッサと同一の構成要素で成り、各構成要素が第1のマイクロプロセッサの対応する構成要素と相互に面対称の位置に配置されている第2のマイクロプロセッサが形成されている第2のチップとを有し、第1, 第2のチップは、裏面が相互に貼り合わされてIC基板に固定されている。

【0005】第1,第2のマイクロプロセッサはそれぞれ、第1,第2のCPUと、それぞれのCPUが実行すべきプログラムが格納される第1,第2のキャッシュメモリ手段と、それぞれのキャッシュメモリ手段に読み込むべきプログラムが格納されている外部メモリを外部バスを介してアクセス制御し、かつ、第1,第2のキャッシュメモリ手段をそれぞれアクセス制御する機能を有する第1,第2の外部メモリアクセス制御手段と、第1および第2のCPUのアクセス要求に従ってアクセスされる第1,第2の共有メモリ手段を有する。

【0006】第1,第2のマイクロプロセッサは、さらに、前記外部バスを優先使用するための外部バス使用権と、第1および第2の共有メモリ手段へのアクセスを優先実行するための共有メモリアクセス権との両者を、第1,第2のマイクロプロセッサのいずれか一方に設定する優先権設定手段を有する。

#### [0007]

【作用】面対称に構成された2つのマイクロプロセッサが背中合わせに貼り合わされているので、処理能力が向上すると共に実装面積が削減される。各マイクロプロセッサは固有のCPUと固有の周辺装置を備えているので、独立に動作することができ、その独立動作にしてのを相互に競合する部分については、その使用についてを発権を設定して競合を回避することができる。2つののでもできる共有メモリ手段をそれぞれ備えているので、各共有メモリ手段は、各マイクロプロセッサの独立の相互通信に使用することができる。このように、本発明のデュアル マイクロプロセッサ装置は独立動作が可能で、かつ、相互通信手段を備えているので負荷分散処

理に適している。

#### [0008]

【実施例】次に、本発明の実施例を図面を参照して説明 する。図1は本発明のデュアルマイクロプロセッサ装置 の一実施例の斜視図である。図2は本発明のデュアルマ イクロプロセッサ装置の一実施例のブロック図である。 図1には、面対称のマスクパターン群によって製造され たマイクロプロセッサのチップA、Bを裏面同士貼り合 わせ、IC基板にボンディングされたデュアル マイク ロプロセッサ装置の外観が示され、チップA, Bの対応 する端子はボンディング端子TEによって接続されてい る。このボンディング端子のうちの1対のボンディング 端子TE<sub>1</sub>, TE<sub>2</sub> (TE<sub>2</sub> は図示されていない) は後 述するように、マイクロプロセッサのマスタ・スレーブ 動作の指定をするために用いられ、その指定は、本実施 例においては、その一対のボンディング端子のうちのス レーブ マイクロプロセッサに接続される端子TE2を グランド接続する (図2参照) ことによって行われる。 【0009】図2において、マイクロプロセッサ1、2 は、その構成要素が面対称に位置するように製造されて いる。図中、黒い丸印しは、ボンディング端子によって、 '相互に接続されるマイクロプロセッサの端子を示す。C PU10, 20は、キャッシュメモリ11, 21に格納 されているプログラムに従って演算・制御を行う。外部 メモリ (EM) アクセス制御回路12, 22は、CPU 10,20が実行すべきプログラムが格納されている外 部メモリ(図示せず)を外部バス300を経由して読み 出すために、当該外部メモリを読み出し制御をすると共 に読み出されたプログラムをキャッシュメモリ11.2 1に書き込むための書き込み制御を行なう。2つの外部 メモリアクセス制御回路12,22が1つの外部バス3 00を使用することによって生ずる競合は、一方のマイ クロプロセッサに優先権を付与してマスタプロセッサと し、マスタプロセッサに所属する外部メモリアクセス制 御回路にバス使用権を与えることによって回避される。 以下、優先権が付与されないマイクロプロセッサをスレ ーブプロセッサと呼称する。

【0010】前記したように、本発明のデュアル マイクロプロセッサ装置は、負荷分散を目的とする分散処理システムを構成する。従って、一方のマイクロプロセッサが実行した処理結果を他方のマイクロプロセッサに通信する通信システムを備えている。本実施例の通信システムは、それぞれのマイクロプロセッサに設けられた共有メモリ16,26は、CPU10および20の双方によってアクセスされることができる。両方のCPU10,20が同時にアクセスすることによって生ずるアクセス競合は、マスタ プロセッサからのアクセス要求を優先して実行させることによって回避される。各々の共有メモリ16,26は、構造的にはデュアル ポート メモリ(D

PM)で、通信用メモリ13,23とDPM制御回路14,24によって構成されている。DPM制御回路14は、CPU10から書き込みまたは読み出し要求があった場合には、通信用メモリ13を制御してCPU10が指定する情報を書き込み、または読み出す。同様に、DPM制御回路24は、CPU20から書き込み、または読み出し要求があった場合には、通信用メモリ23を制御してCPU20が指定する情報を書き込み、または読み出す。

【0011】CPU間の通信は、送信側の通信用メモリ の読み出しと、受信側通信用メモリの書き込みを並行し て実行することによって、達成される。CPU20がC PU10に送信要求を送ると、DPM制御回路14は、 CPU20が指定する情報を通信用メモリ13から内部 バス100上に読み出し、DPM制御回路24は、その 情報を通信用メモリに書き込む。同様に、CPU10か らの送信要求があったとき、DPM制御回路24は、C PU10が指定する情報を通信用メモリ23から内部バ ス200上に読み出し、DPM制御回路14は、その情 報を通信用メモリ13に書き込む。通信用メモリに格納 され、CPU間通信で送受信される情報は、それぞれの CPUが実行したジョブの識別番号、当該ジョブの処理 結果を格納している外部共有メモリ (図示せず) のアド レス、当該ジョブの実行が終了したか、否かの情報等、 それぞれのCPUの処理結果に関する情報である。

【001.2】2つのCPU10,20から外部メモリへ のアクセスの競合、共有メモリへのアクセスの競合は、 優先権設定回路によって回避される。優先権設定回路 は、+5Vの電源、該電源に接続されたプルアップ抵抗  $R_1$  ,  $R_2$  、プルアップ抵抗によってプルアップされる 優先権設定線104,204で成り、各々の優先権設定 線104,204の一端は、ボンディング端子TE,, TE2に接続されている。本実施例では、マイクロプロ セッサ2をスレーブプロセッサに設定するためにボンデ ィング端子TE2 がグランド接続されている。それぞれ の優先権設定線104,204は、DPM制御回路およ び外部メモリアクセス制御回路の優先権設定信号入力に 接続されている。したがって、DPM制御回路14は論・ 理1の優先権設定信号に従って、また、DPM制御回路 24は論理0の優先権設定信号に従って、CPU10か らのアクセス要求をCPU20からのアクセス要求に優 先させて処理する。外部メモリアクセス制御回路12は 論理1の優先権設定信号を入力すると、自回路12が外 部バス300の使用権をもっていることを認識して外部 メモリへのアクセスを処理する。外部メモリアクセス制 御回路22は論理0の優先権設定信号を入力すると、自 回路22が外部バス300の使用権をもっていないこと を認識し、外部メモリアクセス制御回路12の許可を得 て(外部メモリアクセス制御回路12の、外部バス使用 中を示す標識が立っていないことを確認して)外部メモ

リをアクセスし、または、外部メモリアクセス制御回路 12を介して外部メモリをアクセスする。後者の場合に は、スレーブ側外部メモリアクセス制御回路22は、外 部アクセスをマスタ側外部メモリアクセス制御回路12 に伝達するのみである。

【0013】割込み信号線301は、ボンディング端子

を経て割込み選択回路15,25に接続され、複数の割

込み要求信号を伝送する。割込み選択回路15,25 は、それぞれのCPU10、20に割当てられているジ ョブと、割込み要求信号が示す割込み処理内容とを比較 し、それぞれのCPUに割当てられているジョブに該当 する割込み要求信号以外の割込み要求信号を選択的にマ スクし、当該ジョブに該当する割込み要求信号を信号線 103,203を介してCPU10,20に伝送する。 【0014】図2において、信号線101,201は、 キャッシュメモリ11,21にCPU10,20が実行 すべきプログラム、またはCPU10, 20がプログラ ムを実行するために必要なデータが存在しない場合に、 キャッシュメモリ11,21側から外部メモリアクセス 制御回路12, 22へ、外部メモリへのアクセス要求を 伝送する制御線、および、外部メモリから送信されたプ ログラムまたはデータを外部メモリアクセス制御回路1 2,22を介してキャッシュメモリ11,21に伝送す るデータ線およびアドレス線を表わす。外部バス300 は、アドレス線、データ線、制御線から成るバスであ る。信号線102、202は通信用メモリのアクセスの ためのアドレス線、データ線および制御線である。

【0015】次に、本実施例の動作を説明する。先ず、 第1, 第2のマイクロプロセッサの外部バスの使用競 合、および共有メモリ16、26へのアクセス競合を回 避するために、ボンディング端子TE。をグランド接続 して、マイクロプロセッサ1に優先権を設定する。通 常、CPU10はキャッシュメモリ11のプログラムに より動作を行うため外部メモリヘアクセスを行う必要が ないが、キャッシュメモリ11上に、必要なプログラム または必要なデータが無い場合には外部メモリアクセス 制御回路12の制御のもとで外部メモリからプログラム またはデータをキャッシュメモリ上に読み出す。同様に CPU20はキャッシュメモリ21のプログラムにより 動作を行うため外部メモリヘアクセスを行う必要がない が、キャッシュメモリ21上に、必要なプログラムまた は必要なデータが無い場合には、キャッシュメモリ21 はスレーブ側外部メモリアクセス制御回路22に外部メ モリへのアクセス要求を送信し、スレーブ側外部メモリ アクセス制御回路22は、マスタ側外部メモリアクセス 制御回路12の許可を得て外部メモリをアクセスする。 また、この場合の他の実施例として、キャッシュメモリ 21は、外部メモリアクセス制御回路22を介してマス タ側外部メモリアクセス制御回路12にアクセス要求を だし外部メモリアクセス制御回路12の制御のもとで外

部メモリからプログラムまたはデータをキャッシュメモリ上に読み出しを行う。このときスレーブ側外部メモリアクセス制御回路22は単に外部アクセスをマスタ側外部メモリアクセス制御回路12に伝えるのみである。CPU10,20が実行するジョブは、分散負荷である。したがって、それぞれのCPUは、当該CPUが実行した処理結果に関する情報を一旦、共有メモリ16,26に蓄積した後、CPU10による読出しを優先させた上で、必要に応じて共有メモリ16,26を読み出すことによって、それぞれの処理結果を通信する。

【0016】割込み要求が生じたときには、負荷分散によって、それぞれのCPUに割り当てられているジョブに該当する割込み要求を当該CPUが受付ける。このように、割込み処理内容によって、それぞれのCPUに該当する処理を当該CPUに実行させることにより、負荷分散が達成される。

#### [0017]

【発明の効果】以上説明したように、本発明は次の効果 を有する。

【0018】1)面対称に構成された2つのマイクロプロセッサが背中合わせに貼り合わされているので、処理能力が向上すると共に実装面積が削減される。2)各マイクロプロセッサは固有のCPUと固有の周辺装置を備えているので、独立に動作することができ、その独立動作によって相互に競合する部分については、その使用について優先権を設定して競合を回避することができる。3)2つのマイクロプロセッサは、各々のCPUによってアクセスすることができる共有メモリ手段をそれぞれ

備えているので、各共有メモリ手段は、各マイクロプロセッサの独立動作のために使用されると共に、マイクロプロセッサ間の相互通信に使用することができる。4)このように、独立動作が可能で、かつ、相互通信手段を備えているので負荷分散処理に適している。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のデュアル マイクロプロセッサ装置の 一実施例の斜視図である。

【図2】本発明のデュアル マイクロプロセッサ装置の 一実施例のブロック図である。

#### 【符号の説明】

1, 2	マイクロプロセッサ
10,20	CPU ·

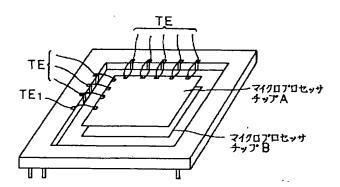
101, 102, 103, 201, 202, 203

#### 信号線

TE, TE<sub>1</sub>, TE<sub>2</sub> ボンディング端子

 $R_1$  ,  $R_2$  プルアップ抵抗

#### 【図1】



【図2】

